2024/6/17：听单总整体讲解了一下。

1. 仪表部分
   1. 源表，2400使用GPIB，2602做了一些封装，使用起来会简单一些。安装好2602驱动后会有样例程序，包括逐点扫描，trigger扫描等等
      1. 串行。发送一个指令设置电流，然后发送一个指令读取电压~~（如果是自己这个通道，可以直接读，如果是不同的通道，需要接线，接电阻）~~（不管是不是都在同一个通道，都需要接电阻，如果在自己同一个通道，自己trigger自己通道不用接Trigger线，其他通道需要接Trigger线）。优点是精度高，缺点是速度慢。
      2. Trigger。发送多个点，以及间隔周期，然后按照事先约定的周期，在最恰当的时机读取数据。优点是速度快，缺点是~~精度低~~时序要求极高，有时需要借助示波器看采样信号是否正确，水清很熟悉。对比精度时，可以串行逐点扫描扫一组数据，trigger扫描一组数据，看两组数据值是否可以对的上。
   2. 光功率计
      1. 要注意Range问题，如果Range选得不对，会降低精度，有的功率计选择autorange后，会自动根据输入功率调节挡位。
   3. 品牌。KeySight前身是安捷伦
2. 光芯片部分
   1. 芯片厂设计芯片，并且会指导工艺（比如晶圆上的~~测试沟道~~trench深度宽度、芯片layout设计等））。Fab厂制造wafer。我们~~检测晶圆，做耦合封装，进行芯片缺陷检测（点墨）~~做晶圆测试、芯片测试，器件耦合封装，晶圆/芯片缺陷检测等；如果晶圆级别做了水平耦合（罗龙正在做的），那么芯片测试项目就会大幅减少，节省芯片测试时间和成本。
   2. 找光：分步调整~~发射装置~~入光位置和~~接受~~出光装置，~~使得输出曲线在9个点的维度上接近高斯曲线。高斯曲线的顶点即为要找的点。~~出光端一般接到光功率计，或者经过光电转化后接到源表进行反馈。找光方式有十字找光、矩阵找光；2D找光以及包括光轴方向的3D找光。每种找光具体如何实现参考代码。
   3. 通过晶圆的新工艺，使得在晶圆测试阶段，即可完成~~侧向测试~~水平耦合（EC即Edge Coupler; 常规方式是GC光栅耦合->Grating Coupler)，从而将芯片测试部分的工作整合到晶圆测试，大大提升效率。
3. 安全问题
   1. 晶圆很贵
   2. ~~找~~回原点之前，先把晶圆拿下来。
   3. ~~找~~回原点时，最开始先一个轴一个轴进行